

御 得 意 様 各 位

第 2 3 回 半 導 体 ・ セ ン サ パ ッ ケ ー ジ ン グ 技 術 展 出 展 の ご 案 内

拝啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 弊社はこのたび「第23回 半導体・センサパッケージング技術展」にて、実績豊富な電子部品用および半導体パッケージングプロセス用表面処理技術に加え、新たな技術および新規製品を多数出展いたします。
 また、HPに展示会特設ページを開設し、下記 URL より出展製品をダウンロードして頂けるようにいたしました。
 是非ご来場賜り、弊社出展品をご高覧頂きたくご案内申し上げます。

敬具

記

日 時：2022年1月19日(水)～1月21日(金)

開場時間：10：00～18：00

※最終日は17：00まで

会 場：東京ビッグサイト：東3ホール・25-34

出展製品：<https://www.meltex.com/nepcon2022.html>
 URL

